

熱ダメージレスの焼結材

Heat damageless
sintering material

低温焼結性銅粉

Low temperature
sinterable Cu
powder

CH-0200L1、CH-0200DP

用途

ダイボンディング材料、配線材料、電極材料
Die-bonding, Wiring, Electrode.

概要・特徴

- ・ 焼結に特化した2タイプの粉体技術
Two types of powder core technology specializing in sintering.
- ・ 190℃の低温かつ短時間処理により焼結可能
Sintering at 190 degrees C in a short time.
- ・ 半導体接合や微細配線などの焼結フィラーとして活用を期待
Used as a sintering material for the die-bonding and fine wiring process.



Fig. Copper powder

